

# 電子部品用・配線用銀ペースト

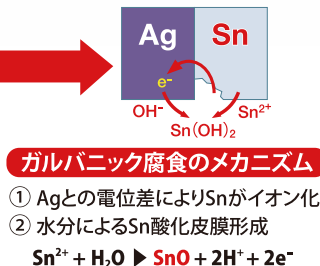
錫めっき部品にも対応した部品実装／優れた印刷性による配線形成

ST-200、SA-4000、SA-3758、SCE-100、SP-100

## 電子部品実装、電子部品電極用銀ペースト

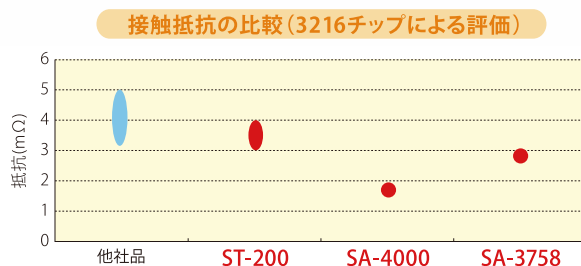
ST-200は錫めっき部品を銀ペーストで実装するとき発生するガルバニック腐食を独自の技術で解決したペーストです。SAシリーズは低接触抵抗かつ高強度で電子部品と接合できます。

### 錫めっき電極部品に対する高信頼性 (ST-200)



樹脂の耐水性UPで劣化を抑制

### 低接触抵抗を実現 (SAシリーズ)



### ● ST-200、SA-4000、SA-3758のスペック (代表値)

項目	ST-200	SA-4000	SA-3758	付記
特徴	錫めっき電極部品対応	低接触抵抗	低収縮、高強度	
粘度	100 Pa·s	50 Pa·s	40 Pa·s	スパイラル粘度計 (10rpm, 25℃)
溶剤含有率	1%	4%	無溶剤	質量分率
バインダー	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	
硬化条件	150℃×60min	170℃×60min	170℃×60min	大気炉
体積固有抵抗率	$8.0 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	$2.5 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	$5.0 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	
接合強度	70 N	50 N	100 N	3216チップを搭載、ダイシエア強度

## 配線用銀ペースト

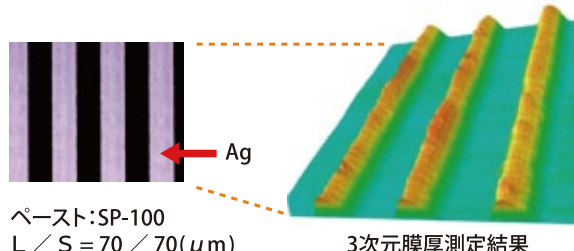
優れたスクリーン印刷性、電気特性 (低抵抗) を有した配線形成用銀ペーストです。

### ● 優れた印刷性と形状保持性

太陽電池セルへの印刷事例



PETフィルムへの印刷事例



### ● SCE-100、SP-100のスペック (代表値)

項目	SCE-100	SP-100	付記
特徴	ファインピッチ対応、低抵抗	ファインピッチ対応、高密着性	
銀含有率	88%	81%	質量分率
粘度	100 Pa·s	40 Pa·s	スパイラル粘度計 (10rpm, 25℃)
バインダー	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	
含有溶剤成分	n-ブチルカルピトールアセテート	n-ブチルカルピトール	
硬化条件	200℃×30min	130℃×20min	大気炉
体積固有抵抗率	$1.2 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	$3.0 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	
鉛筆硬度	H	H	JIS K 5600